

第三代功率半导体 SiC · GaN

芯片良率
大幅度提升!!
其中的秘密



更可靠、更安全地运输昂贵且珍贵的晶圆

防止对薄、硬、脆材质晶圆的损坏



降低损坏风险

为半导体产品专门研发了有专利技术的树脂材料，用其制作的晶圆容器能大幅降低晶圆破损的风险。

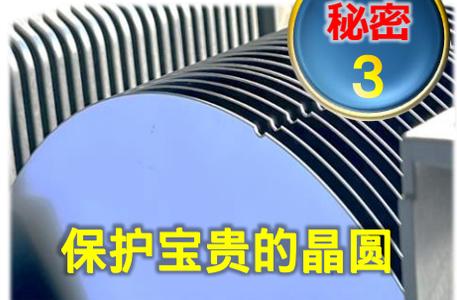
防止因磨损而产生的微颗粒



洁净室环境污染风险大幅减少

优异的耐磨损性能可以最大限度地减少在晶圆运输过程中产生的粒子。大大降低洁净室环境污染风险，保护产品质量。

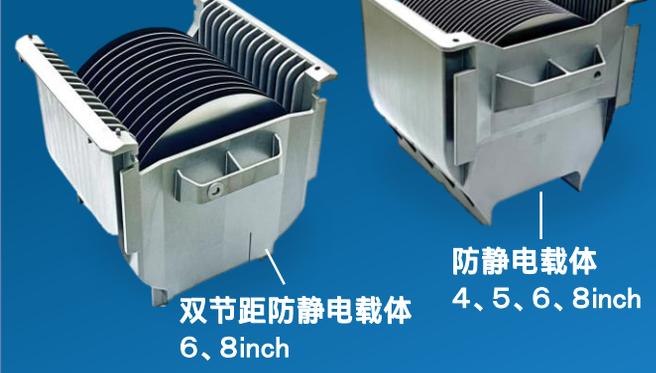
避免使用过程中尺寸变化导致晶圆损坏的风险



保护宝贵的晶圆

具有高尺寸稳定性的设计，防止因搬运过程中尺寸的变化而导致晶圆破损或机器故障。您可以放心地运送宝贵的产品。

半导体容器「Paragon」系列



双节距防静电载体 6、8inch

防静电载体 4、5、6、8inch

半导体容器「Paragon」的特性《构筑信任的实绩表现》

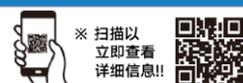
Pragon系列产品已经被以世界上最大的芯片代工厂为代表的100多家全球企业长期采用了20多年。这是我们产品的可靠性和性能最好的证明!



专利材料「e-mateX®」系列



※请参阅背面了解详细信息。



专利材料

「e-mateX®」系列

高性能产品

- FB-0210 系列
- FB-0220 系列
- FB-0430 系列
- FB-0530 系列



「e-mateX®」包括

环状烯烃系树脂特征

- 低吸水性
- 尺寸稳定性优异
- 耐腐蚀性优异
(对酸、碱、极性有机溶剂耐受性)

添加独特功能

原创改性的特殊树脂

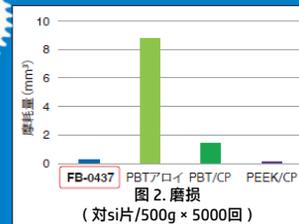
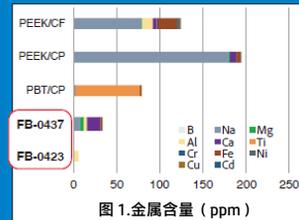
「e-mateX®」

一种塑料材料，为半导体及液晶产品用途单独研发的专利材料。半导体及液晶用途产品有20年以上的销售实绩！具有高纯度、低发尘特性的清洁树脂材料。可以根据用途进行进一步开发的材料！

「e-mateX®」的特性

- 耐磨损性优异
- 对接触的产品友好
(不损伤接触的产品)
- 加工性优异
(射出成型、切削成型等)
- 低污染性
(低排气、低含有金属、低溶出金属)
- 代替PFAS材料 (可应对规则限制：e-mateX®FB-0430系列)

【适用实例】



半导体容器

「Paragon」系列

高性能产品

「Paragon」的特性

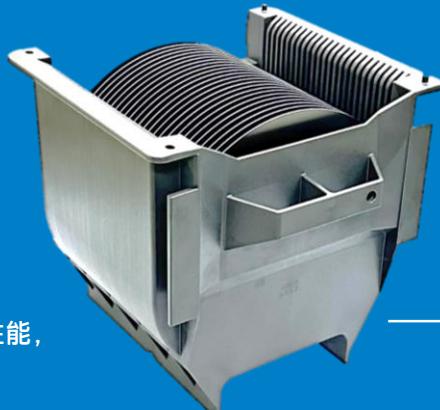
※消除搬运故障

- 耐磨损性、耐腐蚀性
实现晶圆的长期品质保持。
- 低排气性
防止晶圆被污染。
- 防静电功能
抑制静电造成的伤害。
- 高性价比
提供与PEEK材料载具相当的性能，但成本更低。



双节距防静电载体

6,8inch



防静电载体

4,5,6,8inch

中国辽宁省大连经济技术开发区东北三街33号

联系地址

0411-87625111



※扫描以立即查看详细信息!!



大连富士塑料有限公司
FUJI BAKELITE CO.,LTD.

yuyuyong@fujiplastics.com.cn
sosongjinqiao@fujiplastics.com.cn

请在此处通过电子邮件联系我们